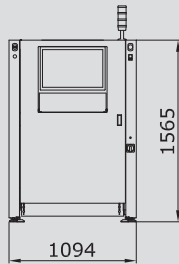


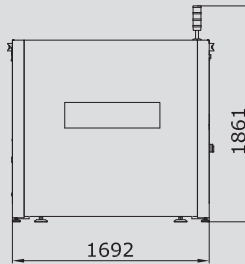
S3088 DT | Systemvariante 3D-SPI – Technische Daten



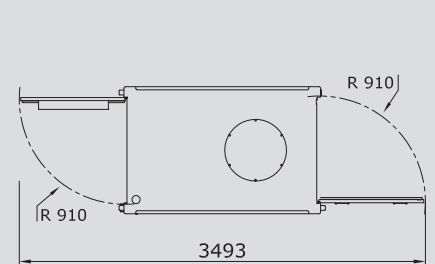
Vorderansicht



Seitenansicht



Draufsicht



Angaben in mm

		S3088 DT Systemvariante 3D-SPI
Inspektionsumfang	3D-SPI	Kontrolle Lotpastendepots Schablonendruck und Dispense-Technologie (bis Padgröße 01005-Bauteile) und auch Sinterpaste möglich; Prüfung von Anwesenheit, Fläche, Höhe, Druckversatz (X/Y-Versatz), Verschmierung und optional: Form, Koplanarität, Freiflächenanalyse, OCR, DCM
Sensorik	3D-Sensorik	
	Messverfahren	Streifenprojektion
	Z-Auflösung	0,1 µm
	Z-Messbereich	4 mm
	Schrägsichtskameras	
	Anzahl der Megapixelkameras	4
Orthogonale Kamera		
	Auflösung	20 µm Standard, 10 µm High-Resolution
	Bildfeldgröße	58,2 mm x 58,2 mm
Software	Bedienoberfläche	Viscom vVision/EasyPro
	Statistische Prozesskontrolle	Viscom SPC, offene Schnittstelle (optional)
	Verifikationsplatz	Viscom vVerify/HARAN
	Remote-Diagnose	Viscom SRC (Software Remote Control) (optional)
	Programmierplatz	Viscom PST34 (optional)
Systemrechner	Betriebssystem	Windows®
	Prozessor	Intel® Core™ i7
Leiterplattenhandling	Transportkonzept	Doppelspur-Transport
	Leiterplattengröße (L x B)	450 mm x 350 mm, Mindestbreite 70 mm
	Übergabehöhe	900 - 950 mm ± 20 mm
	Breitenverstellung	Automatisch*
	LP-Klemmung	Pneumatisch
	Obere Durchfahrtshöhe (max.)	50 mm
Untere Durchfahrtshöhe	40 mm*	
Sonstige Systemdaten	Verfahr-/Positioniereinheit	Synchron-Linearomotoren
	Schnittstellen	SMEMA (Standard), IPC Hermes Standard, andere Schnittstelle auf Anfrage
	Anschlusswerte	400 V (andere Spannungen auf Anfrage), 3P/N/PE, 8 A, Druckluft max. 10 bar (Arbeitsdruck 4 - 6 bar)
	Systemmaße	1094 mm x 1565 mm x 1692 mm (B x H x T)
	Gewicht	1400 kg

* Verschiedene Breitenverstellungen bzw. Durchfahrtshöhen auf Anfrage.